

2008年3月期 第2四半期決算に関する補足資料

億円未満は切り捨て表示しています

1. 第2四半期決算概要(2007年7月~2007年9月)
(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第2四半期 2006.7-2006.9	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	増減率
売上高	2,113	2,638	24.9%
営業利益	323	519	60.5%
経常利益	314	546	73.6%
税前利益	311	557	78.7%
当期純利益	209	362	73.2%

	2007年3月期 中間期 2006.4-2006.9	2008年3月期 中間期 2007.4-2007.9	増減率
	3,905	4,763	22.0%
	582	950	63.1%
	582	957	64.6%
	584	982	67.9%
	372	624	67.8%

2. 部門別・地域別 売上高
(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第2四半期 2006.7-2006.9	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	増減率
半導体製造装置			
国内	446	630	41.2%
米国	252	313	24.2%
欧州	108	65	39.9%
韓国	231	196	14.9%
台湾	363	794	118.6%
中国	104	66	36.3%
東南アジア他	72	67	6.9%
海外計	1,133	1,504	32.7%
計	1,579	2,134	35.1%
FPD製造装置			
国内	50	128	152.6%
韓国	53	57	7.0%
台湾	125	15	87.6%
中国・東南アジア他	6	20	210.7%
海外計	185	93	49.7%
計	236	222	6.1%
電子部品・情報通信機器			
国内	271	254	6.5%
海外	22	26	18.2%
計	294	280	4.6%
その他			
国内	2	1	58.1%
海外	-	-	-
計	2	1	58.1%
連結合計			
国内	771	1,014	31.4%
海外	1,341	1,624	21.1%
計	2,113	2,638	24.9%

	2007年3月期 中間期 2006.4-2006.9	2008年3月期 中間期 2007.4-2007.9	増減率
	778	946	21.6%
	531	524	1.3%
	246	144	41.4%
	411	411	0.1%
	624	1,419	127.4%
	142	205	43.6%
	103	141	36.1%
	2,060	2,846	38.1%
	2,839	3,792	33.6%
	162	237	45.9%
	90	121	33.9%
	217	56	74.2%
	54	20	61.6%
	363	198	45.3%
	525	436	17.1%
	498	485	2.6%
	36	47	29.1%
	535	532	0.4%
	5	2	56.5%
	-	-	-
	5	2	56.5%
	1,445	1,671	15.7%
	2,460	3,092	25.7%
	3,905	4,763	22.0%

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

単位:億円

	2007年3月期 第2四半期 2006.7-2006.9	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	増減率
産業用電子機器			
売上高	1,826	2,360	29.2%
営業費用	1,518	1,850	21.9%
営業利益	307	510	65.7%
電子部品・ 情報通信機器			
売上高	297	283	4.8%
営業費用	281	274	2.7%
営業利益	16	9	41.0%
消去又は全社			
売上高	10	5	-
営業費用	10	5	-
営業利益	0	0	-
連結			
売上高	2,113	2,638	24.9%
営業費用	1,789	2,119	18.4%
営業利益	323	519	60.5%

	2007年3月期 中間期 2006.4-2006.9	2008年3月期 中間期 2007.4-2007.9	増減率
	3,384	4,236	25.2%
	2,821	3,304	17.1%
	563	931	65.4%
	540	538	0.5%
	521	519	0.3%
	19	18	6.6%
	20	10	-
	19	11	-
	0	0	-
	3,905	4,763	22.0%
	3,323	3,813	14.8%
	582	950	63.1%

4. 受注高
(連結)

	2007年3月期 第2四半期 2006.7-2006.9	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	増減率
半導体製造装置	1,886	1,202	36.2%
FPD製造装置	275	73	73.3%
電子部品・情報通信機器	273	260	4.9%
その他	2	1	58.1%
合計	2,437	1,537	36.9%

単位:億円

	2007年3月期 中間期 2006.4-2006.9	2008年3月期 中間期 2007.4-2007.9	増減率
	3,812	2,654	30.4%
	571	114	79.9%
	550	535	2.7%
	5	2	56.5%
	4,939	3,308	33.0%

5. 受注残高
(連結)

	2007年3月期 第2四半期 2006.9末	2008年3月期 第2四半期 2007.9末	増減率
半導体製造装置	3,464	2,931	15.4%
FPD製造装置	1,036	331	68.1%
電子部品・情報通信機器	143	144	0.6%
合計	4,644	3,407	26.6%

単位:億円

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費
(連結)

	2007年3月期 第2四半期 2006.7-2006.9	2008年3月期 第2四半期 2007.7-2007.9	増減率
設備投資額	49	57	15.7%
減価償却実施額	45	51	13.8%
研究開発費	145	170	17.8%

単位:億円

	2007年3月期 中間期 2006.4-2006.9	2008年3月期 中間期 2007.4-2007.9	増減率
	96	127	31.9%
	88	98	11.4%
	271	319	17.6%

- * 前下半期より、従来「産業用電子機器」セグメントに区分しておりました「コンピュータ・ネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。なお、2007年3月期第2四半期及び2007年3月期中間期については、変更後の区分により表示しております。
- * 当社の主力製品である半導体製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。